

Raise3D RMF500

大量生産を可能にする超高速造形3Dプリンター。

炭素繊維複合材料に特化した効率、精度、再現性、柔軟性の高い製造ソリューションを提供します。

POINT-01

工業レベルの生産性

- 500×500×500mmの造形サイズ、かつ最大300mm/sの造形速度
- 5000mm/s²以上の加速度を誇るリニアモーター駆動システムを搭載

POINT-02

高い精度と再現性

- 長年の3Dプリンター設計経験とハイエンドの部品を採用することで、連続生産を可能にする高い再現性を実現
- 1μmクローズドループドライブシステムにより、高い位置決め精度を確保

POINT-03

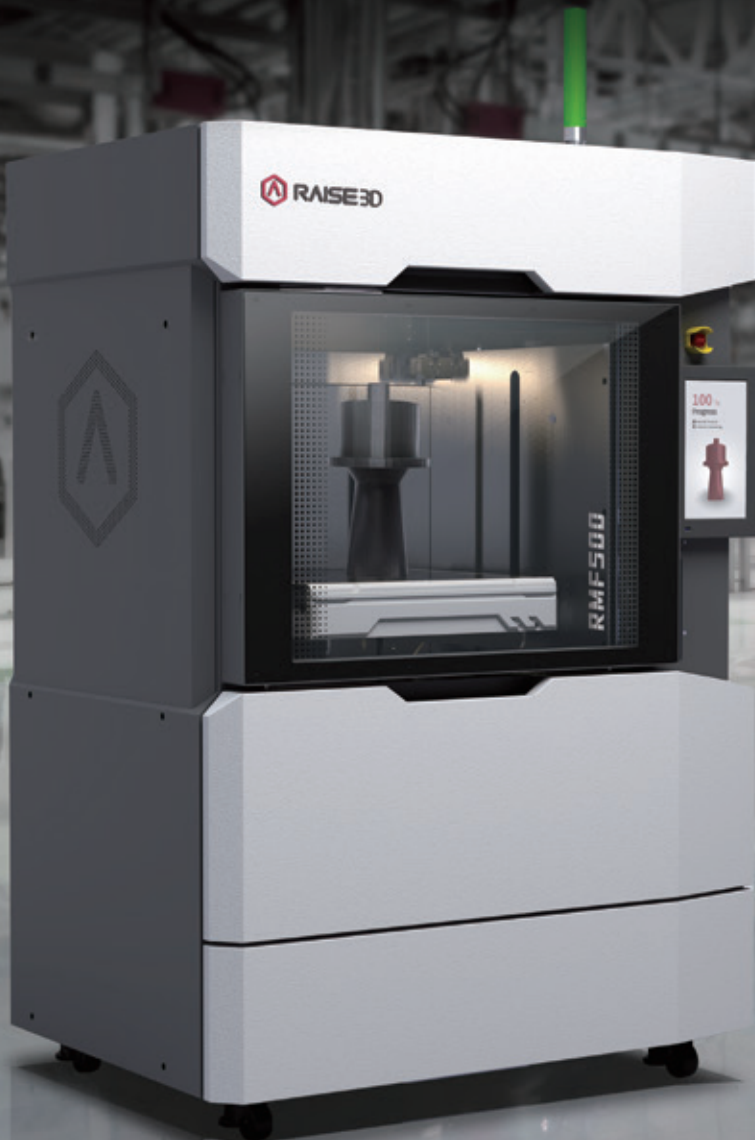
炭素繊維配合の高機能材料

- 炭素繊維複合材料に特化した工業グレードで、高い強度を持った部品を素早く造形できます。
- PA12 CF、PPA CF、PPA GFなど幅広い材料に対応しており、今後さらにPET CFやPPS CFもラインナップに追加予定です。

POINT-04

高いコストパフォーマンス

- RMF500は、高性能でありながら低価格を実現し、より幅広い企業のニーズに対応できます。
- 加熱チャンバーを使用していないため、70%以上のエネルギーを節約可能で、本体と材料の低価格を実現。



Raise3D RMF500

仕様

サイズ	シングルヘッド造形時 (幅×奥行き×高さ)	500×500×500mm
	デュアルヘッド造形時 (幅×奥行き×高さ)	500×500×500mm
	本体サイズ (幅×奥行き×高さ)	1340×990×2370mm
電源	入力	30A@ 三相380V AC
	出力	24V、350W、12V、75W
プリンター	出力技術	FFF(熱溶解フィラメント製法)方式
	プリントヘッド	可動式デュアルヘッド
	フィラメント直径	1.75mm
	位置決め精度	X軸 / 1、Y軸 / 1、Z軸 / 0.09765μm
	出力速度	≤300mm/s
	ビルドプレート	PEIビルドプレート
	最大プラットフォーム温度	110°C
	プラットフォーム材質	スチール
	プラットフォームの水平調整	自動キャリブレーション
	フィラメント種類	PA12 CF / PA12 CF サポート材 / PPA CF / PPA GF / PPAサポート材 (PPS CF、PET CF近日公開)
	積層ピッチ	0.05 - 0.75mm
	ノズル径	0.6mm(標準)、0.8mm(近日公開)
	最大ノズル温度	330°C
	接続方法	Wi-Fi、LAN、USB、Ethernet
推奨動作環境	15 - 30°C、相対湿度30 - 70%	
ソフトウェア	スライスソフト	ideaMaker
	入力ファイル形式	STL、OBJ、3MF、OLTP
	操作システム	Windows、Mac OS、Linux
	出力ファイル形式	GCODE
コントローラ	ユーザーインターフェイス	13.3 inch Touch Screen
	ネットワーク	Ethernet、Wireless 802.11 b/g/n、Dual Mode Wi-Fi
	解像度	1920×1080
	モーションコントローラ	Rockchip ARM Cortex-M4
	制御プロセッサ	Rockchip RK3399 ARM Dual Cortex-A72、Quad Cortex-A53 1.8 GHz
	メモリー	2GB
	オンボードフラッシュ	16GB
	メモリーSDカード	128GB
	OS	組み込みLinux
	ポート	USB2.0 × 1

